

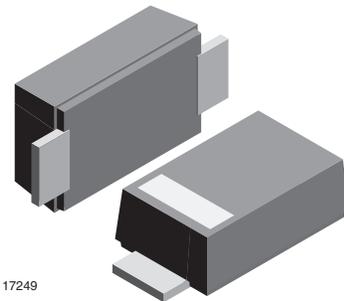
小信号肖特基二极管

特点

- 表面贴片安装应用
- 低尺寸封装
- 自动化放置的理想选择
- 玻璃钝化
- 高温焊接：端子为 260 °C/10 s
- 可使用波峰焊和回流焊焊接
- 符合 AEC-Q101 规格
- 符合 RoHS 指令 2002/95/EC 以及 WEEE 2002/96/EC
- 符合 IEC 61249-2-21 无卤素规范



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE



17249

机械工程数据

封装外壳：DO-219AB (SMF)

极性：标出阴极端

重量：约 15 mg

包装代码 / 选项：

18/10K 每个 13" 卷轴 (8 mm 绕带)

08/3K 每 7" 卷轴 (8 mm 绕带)

产品表格

产品名称	序号编码	标记	备注
SL02-M	SL02-M-18 or SL02-M-08	U2	绕带和卷轴包装
SL03-M	SL03-M-18 or SL03-M-08	U3	绕带和卷轴包装
SL04-M	SL04-M-18 or SL04-M-08	U4	绕带和卷轴包装

绝对最大额定参数

T_{amb} = 25 °C, 除另有规定外

参数	测试条件	产品名称	符号	测试值	单位
最大重复峰值反向电压		SL02-M	V _{RRM}	20	V
		SL03-M	V _{RRM}	30	V
		SL04-M	V _{RRM}	40	V
最大 RMS 电压		SL02-M	V _{RMS}	14	V
		SL03-M	V _{RMS}	21	V
		SL04-M	V _{RMS}	28	V

SL02-M, SL03-M, SL04-M



Vishay Semiconductors

参数	测试条件	产品名称	符号	测试值	单位
最大直流截止电压		SL02-M	V_{DC}	20	V
		SL03-M	V_{DC}	30	V
		SL04-M	V_{DC}	40	V
最大平均正向整流电流	$T_{tp} = 109\text{ }^{\circ}\text{C}$		$I_{F(AV)}$	1.1	A
峰值正向浪涌电流 8.3 ms 单一半正弦波			I_{FSM}	40	A

热特性

$T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 除另有规定外

参数	测试条件	符号	测试值	单位
结点到周围环境空气的热阻 ¹⁾		R_{thJA}	180	K/W
最大工作结点温度		T_j	125	$^{\circ}\text{C}$
存储温度范围		T_{stg}	- 55 至 150	$^{\circ}\text{C}$

注:

1) 安装在 3 mm x 3 mm 环氧玻璃线路板上, 铜衬垫 (厚度 $\geq 40\text{ }\mu\text{m}$)

电气特性

$T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 除另有规定外

参数	测试条件	产品名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
瞬时正向电压	$I_F = 0.5\text{ A}$ ¹⁾	SL02-M	V_F		0.360	0.385	V
		SL03-M	V_F		0.395	0.43	V
		SL04-M	V_F		0.450	0.51	V
典型瞬时正向电压	$I_F = 1.1\text{ A}$	SL02-M	V_F		0.420		V
		SL03-M	V_F		0.450		V
		SL04-M	V_F		0.530		V
额定直流截止电压下的最大直流反向电流	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	SL02-M	I_R			250	μA
	$T_A = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	SL02-M	I_R			8	mA
	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	SL03-M	I_R			130	μA
	$T_A = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	SL03-M	I_R			6	mA
	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	SL04-M	I_R			20	μA
	$T_A = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	SL04-M	I_R			6	mA

注:

1) 脉冲测试, 300 μs 脉冲, 1 % 占空比

典型特性

$T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 除另有规定外

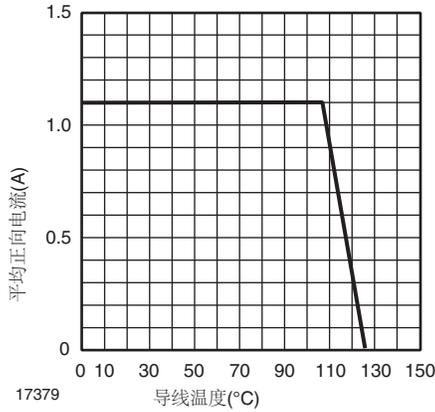


图 1. 正向电流降额曲线

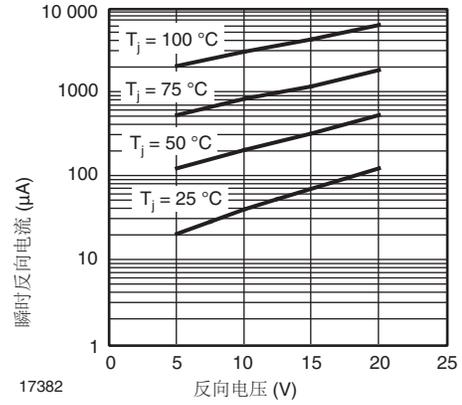


图 4. 典型反向电流特性 - SL02

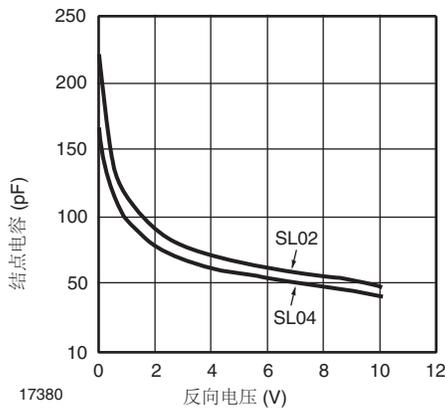


图 2. 典型结点电容

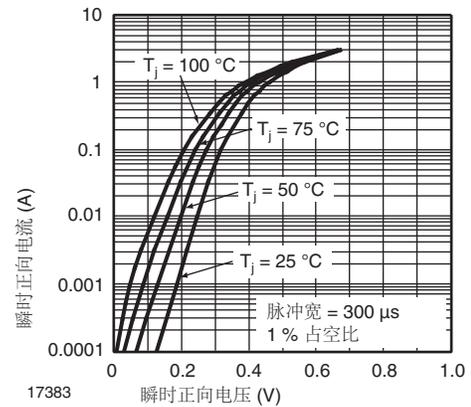


图 5. 典型瞬时正向特性 - SL03

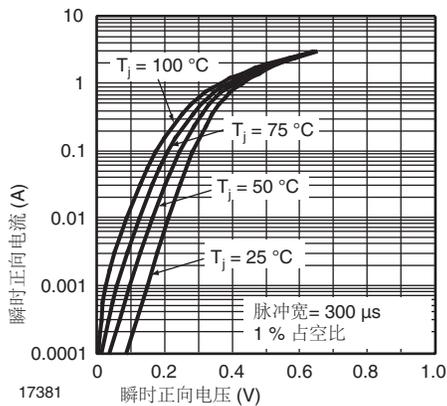


图 3. 典型瞬时正向特性 - SL02

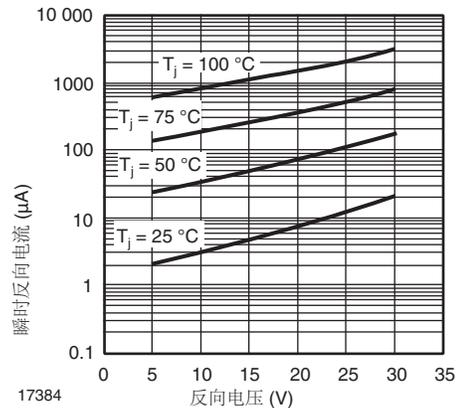


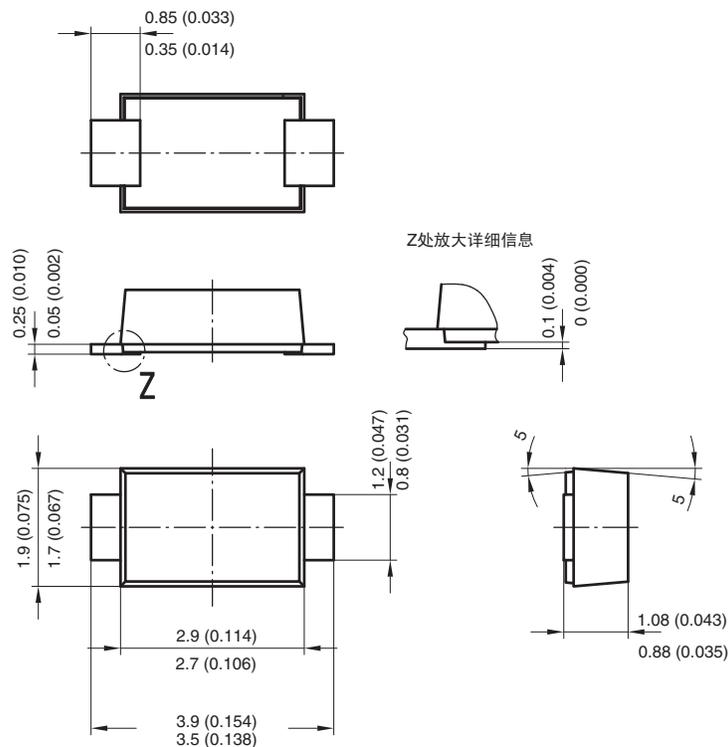
图 6. 典型反向电流特性 - SL03

SL02-M, SL03-M, SL04-M

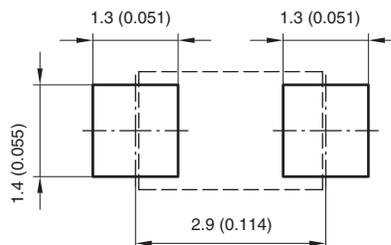


Vishay Semiconductors

封装尺寸 毫米 (英寸): DO-219AB

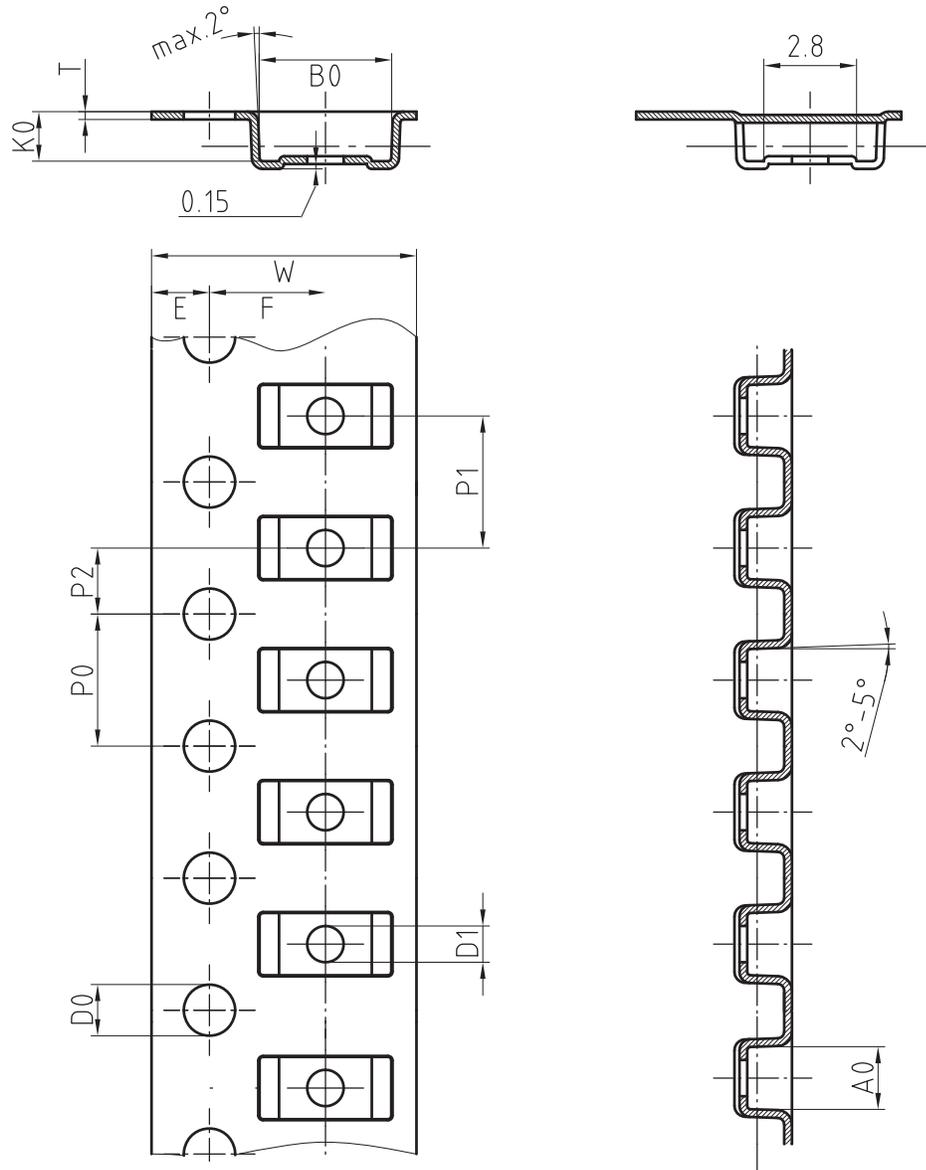


占位面积推荐:



创建时间: 2005年2月15日
第三次修改日期: 2007年3月
文件编号: S8-V-3915.01-001 (4)
17247

SMF 吸塑带工艺尺寸 毫米



Mat:	A0	B0	K0	W	T	P0	P2	P1	D0	D1	E	F
PS	1.9	4.0	1.5	8.0	0.235	4.0	2.0	4.0	1.5	1	1.75	3.5

文件编号: S8-V-3717.02-001 (3)

18513

2008 年 7 月 7 日

免责声明

所有产品规格及数据如有更改，恕不另行通知。

对于本文所含内容或其他与任一产品相关的任何发布中的任何错误、不准确或不完整问题，Vishay Intertechnology, Inc. 及其子公司、代理及员工，以及代表该公司的所有人（统称为“Vishay”）不负有任何责任。

在法律所允许的最大程度上，Vishay 放弃因使用或应用本文所述的任何产品或本文所提供的任何信息所产生的任何责任。产品规格没有扩展或者以其他方式修改适用于这些产品的 Vishay 购买条款与条件，包括但不限于本文所述的保修。

本文或 Vishay 的任何行为未提供针对任何知识产权的明示或默示、不容否认或其它形式的许可。

除非明确指出，否则本文所示的产品不用于医疗、生命挽救或生命维持应用。使用或销售未明确指示可在上述应用中使用的 Vishay 产品的客户风险自负，并且同意对于因上述使用或销售行为造成的任何损坏承担 Vishay 的全部赔偿。如欲获得有关指定用于上述应用的产品的书面条款与条件，请与 Vishay 授权人员联系。

本文提到的产品名称及标记应为各自所有者的商标。